公司代码:688498 公司简称:源杰科技

陕西源杰半导体科技股份有限公司

【2023】年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站 www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分。

3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4公司全体董事出席董事会会议。

5立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2023年12月31日,陕西源杰半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”)母公司报表中期末未分配利润为人民币158,001,494.31元,2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),公司不送红股,不进行资本公积转增股本。截至2024年4月24日,公司总股本85,461,670股,扣除目前回购专户的股份余额402,149股后参与分配股数共85,059,521股,以此计算合计拟派发现金红利8,505,952.10元(含税)。占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为43.67%。

公司通过回购专用账户所持有本公司股份402,149股,不参与本次利润分配。

如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

8是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更的股票简称
A股	上海证券交易所科创板	源杰科技	688498	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	程丽	吴晶
办公地址	陕西省西咸新区沣西新城开元路1265号	陕西省西咸新区沣西新城开元路1265号
电话	029-38011198	029-38011198
电子信箱	ir@yj-semitech.com	ir@yj-semitech.com

2报告期公司主要业务简介

(一)主要业务、主要产品或服务情况

1.主要业务情况

公司聚焦于光芯片行业,主营业务为光芯片的研发、设计、生产与销售,目前公司的主要产品为光芯片,主要应用于电信市场、数据中心市场、车载激光雷达市场等领域。其中电信市场可以分为光纤接入,移动通信网络。在光通信领域中,主要产品包括2.5G、10G、25G、50G 、100G以及更高速率的DFB、EML激光器系列产品和大功率硅光光源产品, 主要应用于光纤接入、4G/5G移动通信网络和数据中心等领域。在车载激光雷达领域,公司产品涵盖1550波段车载激光雷达激光器芯片等产品。

经过多年研发与产业化积累,公司已建立了包含芯片设计、晶圆制造、芯片加工和测试的IDM全流程业务体系,拥有多条覆盖MOCVD外延生长、光栅工艺、光波导制作、金属化工艺、端面镀膜、自动化芯片测试、芯片高频测试、可靠性测试验证等全流程自主可控的生产线,公司逐步发展为国内领先的光芯片供应商。公司将继续深耕光芯片行业,致力成为国际一流光电半导体芯片和技术服务供应商。

应用领域			速率	产品类型
电信市场类	光纤接入	光纤接入EPON	25G	1310nm FP
		光纤接入GPON	25G	1310nm DFB
			25G	1490nm DFB
		光纤接入10G PON	25G	1270nm DFB
			10G	1270nm DFB
			10G	1577nm DFB
			10G	1577nm EML
			10G	1577nm w/SOA
		光纤接入25G/50G PON	25G	1300nm DFB
			25G	1296nm DFB
			25G	1358nm EML & 1358nm w/SOA EML
			50G	1286/1342nm EML & 1286/1342nm w/SOA EML
	移动通信网络	4G移动通信网络	10G	1310nm FP
			10G	1310nm DFB
			10G	1310nm Antireflection DFB
			10G	1270～1570nm CWDM16 DFB
		5G移动通信网络	25G	1310nm FP
			25G	10G overclock 1270～1370nm CWDM6 DFB
			25G	1270/1330nm DFB
			25G	1310nm DFB
			25G	1270～1370nm CWDM6 DFB
			25G	LWDM12 Channel DFB
			25G	MWDM12 Channel DFB
			50G	1270～1370nm CWDM6 DFB
数据中心类	数据中心	数据中心	10G	1270～1330nm CWDM4 DFB
			25G	1270～1330nm CWDM4 DFB
			25G	LWDM4 Channel DFB
			50G	1270～1330nm CWDM4 PAM4 DFB
			100G	1270～1330nm CWDM4 PAM4 EML
			100G	1304/1307/1309/1311nm Narrow LWDM PAM4 EML
			200G	1270～1330nm CWDM4 PAM4 EML
			CW	100mW 1310nm CW DFB
			CW	100mW CWDM4 CW DFB
			CW	70mW CWDM4/8 CW DFB
			CW	70mW 1310nm CW DFB
			CW	70Mw LWDM4 CW DFB
			CW	50mW 1310nm CW DFB
			CW	25mW CWDM4 CW DFB
			CW	150mW 1310nm CW DFB
车载激光雷达及传感			/	1550nm Pulse DFB
			/	CH4 sensor

注:

1、2.5G、10G、25G、50G、100G、200G代表激光器芯片的传输速率;CWDM、LWDM、MWDM代表可应用于波分复用网络的激光器芯片;PAM4代表可应用于PAM4脉冲调制技术的激光器芯片;

2、报告期内,公司主要向客户销售激光器芯片,但为满足部分客户需求,公司会将激光器芯片封装后进行销售。

(二)主要经营模式

1.销售模式

公司采取以直销为主、经销为辅的销售模式,设立市场与销售部负责开发客户、产品推广以及维护客户关系。市场与销售部根据客户需求情况制定销售计划,将接收到的订单需求反馈给生产与运营部,协调产品研发、生产、交付、质量等服务工作,同时承担跟单、售后、技术支持等工作。

新产品及客户导入方面,由于光芯片产品设计参数、性能指标多,公司市场与销售部根据客户需求先与其进行深度技术交流,研发部在此基础上进行产品设计、材料选型、样品生产等工作,然后在厂内进行样品性能测试、可靠性测试,并将样品送至客户处进行综合测试。测试通过后,客户会小批量下单采购,并在多批次生产合格后,转入批量采购。公司的成熟产品主要通过展会、现有客户推荐、销售经理开发等方式寻求新客户。

2.采购模式

每月月底采购部根据生产与运营部提供的次月生产计划及安全库存,制定对应的生产原物料采购计划(包括预测需求);原材料采购到货后,品质部负责生产原物料的检验工作,并提供生产原物料的质检项目和质检结果;质检合格后,由仓管科负责核对到货单物料数量与采购订单物料数量,财务部负责最终付款。另外研发部门、生产类部门、厂务部门、行政部门等根据公司经营需要,制定相应各部门采购计划并提前传递采购部审核,由采购部统一采购。

公司制定供应商认证及供应商管理程序,对新的供应商进行资质评估及调查,对提供的样品进行验证,并进行合格供应商评审,合格的供应商将被录入《合格供方名单》。公司对供应商进行绩效考核并分级管理,按需进行物料替代管理、供应商稽核管理,确保公司的采购质量。

3.生产模式

公司生产激光器芯片属于IDM模式,掌握芯片设计、晶圆外延等光芯片制造的核心技术,拥有覆盖芯片设计、晶圆制造、芯片加工和测试等自主生产的能力,公司的IDM模式能够缩短产品开发周期,实现光芯片制造的自主可控,快速响应客户并高效提供相应解决方案,能够迅速地应对动态市场需求。

公司生产以市场需求为导向,生产与运营部根据客户订单协调相关部门制定生产计划。公司根据年度销售策略进行产能评估,提前适当备货以应对需求高峰,保持库存的适度水平,减轻生产压力。

4.研发模式

公司研发以行业发展、应用需求及研发项目为基础,新产品研发流程以研发部《设计和开发控制程序》体系进行管理,从立项开始先后经历6个阶段,主要包括:立项、设计输入输出、工程验证测试(EVT)、设计验证测试(DVT)、研发转生产培训考核、批量过程验证测试优化(PVT)等阶段,各阶段要求满足后进入下一阶段,具体如下:

(1)立项阶段

市场与销售部根据客户及市场需求,提出新项目立项申请,填写《项目研发建议书》,并提交市场与销售部、研发部及总经理共同评审。项目评审通过后,指定项目负责人制作项目可行性分析,包括项目方案概况列举、项目预算、研发过程风险预估与对应措施,确定参与人员、明确客户指标需求等。

(2)设计输入输出阶段

项目负责人根据立项阶段资料,制作设计开发阶段指导文件及流程,包括产品技术参数、工艺指导文件、结构设计、工艺流程设计、环保分析、研发过程失效分析及对应的控制措施等。

(3)工程验证测试阶段(EVT)

研发部根据《设计和开发控制程序》要求进行投片,参照设计输入输出阶段工艺指导文件与流程进行样品试制,在试制结束后对客户需求指标进行测试分析。此阶段针对产品特性与工艺生产异常关闭率进行评审。第一轮样品试制若无法满足客户需求,研发项目团队总结样品试制过程中的问题,进行分析、提出设计更改并重新输出对应指导文件,获得批准后进行下轮样品试制,直到满足客户需求后可转入下一阶段。

(4)设计验证测试阶段(DVT)

研发部根据投片数量进行设计验证测试,对客户需求指标进行测试并分析。此阶段针对产品稳定性与异常关闭率进行评审。设计验证测试结束若无法满足客户需求,研发项目团队总结生产过程中的问题,进行分析、提出设计更改并重新输出对应指导文件,从上一阶段的工程验证测试(EVT)开始开发,直到满足客户需求并通过验证。

(5)研发转生产培训考核阶段

研发转生产培训考核阶段,研发部提供给生产与运营部相关资料,包括输出工艺标准指导书、工单、参数对照表、质检标准、标准工时统计表、试生产任务单等,并根据需求对生产线相应的人员进行培训与考核,通过评审后方可转入下个阶段。

(6)批量过程验证测试优化阶段(PVT)

批量过程验证测试优化阶段(PVT),生产与运营部接收研发转生产阶段文件后,评估产线产能、管理投入设备并分析人员、安全和环境等因素,确认具备量产能力后,制定并组织实施生产计划,投入资源进行批量验证与测试。在批量生产过程中,研发项目团队总结生产过程中的问题,进行分析、提出设计更改并重新输出对应指导文件,直到达到预期目标并通过验证。

(三)所处行业情况

1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1)所处行业

公司聚焦于光芯片行业,主营业务为光芯片的研发、设计、生产与销售。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012修订),公司属于“制造业”中的“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处行业为“C392通信设备制造”之“C3976光电子器件制造”。根据《战略性新兴产业分类(2018)》(国家统计局令第23号),公司所处的行业细分领域为“1新一代信息技术产业”之“1.2电子核心产业”之“1.2.1新型电子元器件及设备制造”之“3976光电子器件制造”。

(2)行业的发展阶段及基本特点

随着全球信息互联网流量不断扩大,光电信息技术正在崛起。在这种趋势下,光芯片的下游应用场景不断扩展,需求量不断增加,同时对光芯片的速率、功率、传输距离也提出更高的要求。目前在电信市场,数据中心市场,光芯片都得到了较为广泛的应用,其中电信市场又可以细分为光纤接入和移动通信两个细分领域。

光纤接入市场:随着千兆光纤网络升级,目前10G PON市场正在广泛的部署,仍然有较大的空间。截至2023年底,三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达6.36亿户,全年净增4,666万户。其中,100Mbps及以上接入速率的用户为6.01亿户,全年净增4756万户,占总用户数的94.5%,占比较上年未提高0.6个百分点;1000Mbps及以上接入速率的用户为1.63亿户,全年净增7153万户,占总用户数的25.7%,占比较上年未提高10.1个百分点。全球范围内,10G PON网络的投资和部署保持较高水平。千兆宽带正在快速普及同时,开始向“千兆+”、“万兆”加速。作为ITU-T定义的下一代PON技术,50G PON比10G PON带宽提升了5倍、时延降低了100倍,具备提供确定性业务体验的能力。根据Omdia的预测,2024至2028年期间,50G PON端口出货量将不断提升,并保持每年200%的复合年增长率。

无线通信市场:3GPP 5G重要标准R18的冻结将加速5G-A的产业成熟和部署应用。5G-A在网络速度、延迟、连接数等方面实现显著提升,同时引入了通感一体、无源物联、内生智能等全新的革命性技术,能更好地匹配人联、物联、车联、高端制造、感知等场景。相关技术的成熟与推广,有望对相关的产业链形成拉动作用。

数据中心市场:随着人工智能的快速发展,模型大小和数据集大小的增加,模型性能提高。训练大模型需要大量算力,导致对光器件的需求、能力的增加。在这样的背景下,数据中心市场高速率需求持续增加。当前,GPU对光模块的需求主要以400G/800G为主,下一代GPU产品将提升至800G/1.6T,这无疑将进一步刺激对高速光模块的需求。对功耗提出更高要求,数据中心对功耗和密度的要求越来越高,因此光模块需要不断优化,以实现更高的能效比和更紧凑的封装设计。低功耗、小型化、集成化将成为未来光模块发展的重要趋势。硅光技术在可插拔光模块中逐步提升,特别在高功耗模块中应用广泛。此外,CPO和LPO方案也是未来趋势,虽然LPO在标准统一和互联互通上仍存在挑战,但其在特定场景中表现出较低功耗和成本的优势。根据Light Counting预测,2027年全球光模块市场规模将突破200亿美元,2022年至2027年复合平均增长率为12%。

(3)主要技术门槛

更高速率、更高功率、更长传输距离的光芯片的技术研发、工艺设计具有更高开发难度与门槛。一方面,随着需求提升,光芯片的结构设计的精度要求极高,技术研发及工艺开发需结合高速射频电路与电子学、微波导光学、半导体量子力学、半导体材料学等多学科,设计合适的芯片结构,满足芯片精度及尺寸的要求;另一方面,激光器芯片的生产需要几十至几百道工序,每道生产工序都将影响产品最终的性能和可靠性,因此对生产线工艺成熟和稳定有极高要求。此外,高速率激光器芯片相较于中低速率产品,在量子阱有源区、光栅层结构区、模斑转化器区域、光波导结构区、电流限制结构区、高频电极结构、谐振腔反射膜等关键结构的设计与开发上,需综合考虑光电特性、产品可靠性、制备工艺可行性等相互制约因素,因此存在极高壁垒。

2.公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司聚焦于光芯片行业,主营业务为光芯片的研发、设计、生产与销售,主要产品包括2.5G、10G、25G、50G、100G及更高速率激光器芯片系列产品等,目前主要应用于电信市场、数据中心市场、车载激光雷达等领域。经过多年研发与产业化积累,公司已建立了包含芯片设计、晶圆制造、芯片加工和测试的IDM全流程业务体系,拥有多条覆盖MOCVD外延生长、光栅工艺、光波导制作、金属化工艺、端面镀膜、自动化芯片测试、芯片高频测试、可靠性测试验证等全流程自主可控的生产线,已实现向国内外主流光模块厂商批量供货,已成为国内领先的光芯片供应商。

在电信市场中,目前所需的2.5G、10G激光器芯片市场国产化程度较高,但不同波段产品应用场景不同,工艺难度差异大,公司凭借长期技术积累实现激光器光源发散角更小、抗反射光能力更强等差异化特性,为光模块厂商提供全波段、多品类产品,同时提供更低成本的集成方案,实现差异化竞争;未来25G/50G PON接入网对光芯片的要求也将进一步提升,大功率、低色散、高速调制的场景需求提升了光芯片的技术门槛,公司已开发相应的集成技术与光放大器集成技术平台,适配高速接入网的需求,使公司的PON光芯片产品具备更强的市场竞争力,进入下一代高速需求的迭代过程。

在数据中心市场中,尤其是以人工智能为代表的应用拉动了400G、800G或以上高速光模块的需求增加,进而带动了高速率、大功率的芯片需求,比如主要为100G PAM4 EML光芯片、70mW、100mW大光功率激光器等。目前数据中心市场仍以海外供应商为主。公司基于多年在光芯片领域的研发和生产积累,已推出相应的高速EML、大功率激光器产品,无论是单波或是多波长的CWDM、LWDM需求,来适配相关的高速光模块的需求,且性能及可靠性等指标可对标海外同类型产品。

3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1)AI推动模块升级,单通道速率逐步提升

随着人工智能技术的快速发展,对算力的需求迅速增长,进一步推动了1.6T光模块的发展。预计1.6T乃至更高速率的光模块将成为数据中心内部连接的新技术趋势,以配合未来更大带宽、更高算力的GPU需求。目前1.6T光模块批量商用的进程正在加速。这一趋势,对光芯片提出更高的要求。包括200G PAM4 EML、CW光源等在内的多种芯片将成为1.6T光模块中光芯片的解决方案。

(2)硅光技术逐渐成为提升成本效率重要方案之一

硅光子技术是基于硅和硅基衬底材料,利用现有CMOS工艺进行光器件开发和集成的新一代技术。AI的爆发导致了对光模块速率和数量的需求极大的增长,降本降功耗变得更为紧迫,这导致了客户对硅光的接受度有望提升。Lightcounting预计使用基于SiP的光模块市场份额将从2022年的24%增加到2028年的44%,LPO有望加速硅光渗透率进一步提升。硅光方案中,CW激光器芯片作为外置光源,硅基芯片承担速率调制功能。CW大功率激光器芯片,要求同时具备大功率、高耦合效率、宽工作温度的性能指标,对激光器芯片要求更高。

(3)光芯片下游应用市场不断拓展

光芯片的应用领域正在不断拓展。在传感领域,如环境监测、气体检测,光芯片被用作传感器,能够检测光信号并转换为电信号,用于数据采集和分析。在汽车领域,随着传统乘用车的电动化、智能化发展,高级别的辅助驾驶技术逐步普及, 核心传感器件激光雷达的应用规模将会增大。基于砷化镓(GaAs)和磷化铟(InP)的光芯片作为激光雷达的核心部件,其未来的市场需求将会不断增加。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	2,236,682,340.61	2,296,683,768.92	-2.57	736,849,937.31
归属于上市公司股东的净资产	2,116,687,842.73	2,102,471,916.64	0.68	614,482,065.92
营业收入	144,403,649.04	282,905,278.42	-48.96	232,106,859.21
归属于上市公司股东的净利润	19,479,815.27	100,316,964.59	-80.58	95,287,767.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-238,669.33	91,866,664.92	-100.26	87,200,831.92
经营活动产生的现金流量净额	-17,399,733.48	37,739,184.13	-146.11	36,033,177.28
加权平均净资产收益率(%)	0.92	14.99	减少14.07个百分点	16.87
基本每股收益(元/股)	0.27	2.23	-87.89	2.12
稀释每股收益(元/股)	0.27	2.23	-87.89	2.12
研发投入占营业收入的比例(%)			增加11.85个百分点	

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	34,853,815.01	26,465,243.09	31,871,133.81	51,213,457.13
归属于上市公司股东的净利润	11,845,367.73	7,545,718.50	2,056,781.00	-1,968,051.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,563,329.13	-445,376.83	-473,715.90	-3,882,905.73
经营活动产生的现金流量净额	-24,961,622.10	-3,657,063.42	-2,601,820.09	13,820,772.13

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	7,612
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	10,401
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	-
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	-

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通出借股份的限售股数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
ZHANG XINGANG	3,017,988	10,562,958	12.45	10,562,958		无		境外自然人
秦燕生	1,315,674	4,604,859	5.43	4,604,859		无		境内自然人
秦卫星	1,279,674	4,478,859	5.28	4,478,859		无		境内自然人
苏州瑞璜股权投资管理合伙企业(有限合伙)-宁波创沛云投资合伙企业(有限合伙)	1,207,422	4,225,977	4.98			无		其他
杭州汉京西成创业投资合伙企业(有限合伙)	1,193,256	4,176,396	4.92			无		境内非国有法人
北京瞪羚金石投权投资中心(有限合伙)	969,606	3,393,621	4.00			无		境内非国有法人
张欣颖	841,158	2,944,053	3.47	2,944,053		无		境内自然人
哈勃科技创业投资有限公司	784,800	2,746,800	3.24			无		境内非国有法人
陕西科迈投资管理合伙企业(有限合伙)-陕西先导光电集成科技投资合伙企业(有限合伙)	676,350	2,367,225	2.79			无		其他
国投创业投资管理有限公司-国投(宁波)科技成果转化创业投资基金合伙企业(有限合伙)	630,216	2,205,756	2.60			无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明			1.ZHANG XINGANG和张欣颖系兄妹关系;2.秦燕生和秦卫星系兄弟关系;3.ZHANG XINGANG与秦燕生、秦卫星、张欣颖为一致行动人;4.公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动人的情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			无					

存托凭证持有人情况

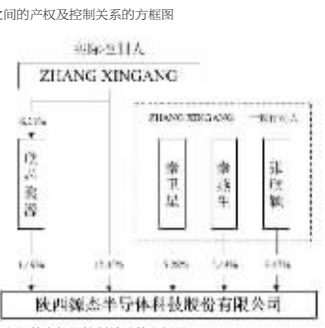
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期公司实现营业收入14,440.36万元, 同比下降48.96%; 归属于母公司所有者的净利润1,947.98万元,同比下降80.58%,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-23.87万元,同比下降100.26%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688498 证券简称:源杰科技 公告编号:2024-026

陕西源杰半导体科技股份有限公司关于2023年年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 每股分配比例:A股每10股派发现金红利1元(含税),不送红股,不进行资本公积转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配及方案内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2023年12月31日,陕西源杰半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”)母公司报表中期末未分配利润为人民币158,001,494.31元。2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),公司不送红股,不进行资本公积转增股本。截至2024年4月24日, 公司总股本85,461,670股, 扣除目前回购专户的股份余额402,149股后参与分配股数共85,059,521股,以此计算合计拟派发现金红利8,505,952.10元(含税)。占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为43.67%。

公司通过回购专用账户所持有本公司股份402,149股,不参与本次利润分配。

如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交2023年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2024年4月24日,公司召开第二届董事会第四次议审议通过了关于《公司2023年年度利润分配方案》的议案,本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司的股东回报规划。并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

(二)监事会意见

2024年4月24日,公司召开第二届监事会第二次会议审议通过了关于《公司2023年年度利润分配方案》的议案。

监事会认为:公司《2023年度利润分配方案》符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,综合考虑了公司运营情况、公司发展阶段、未来发展资金需求、对投资者的合理投资回报和有利于公司长远发展等因素。不存在损害公司及股东、特别是中小股东的合法权益的情形。

并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

(一)本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码:688498 证券简称:源杰科技 公告编号:2024-028

陕西源杰半导体科技股份有限公司关于公司续聘2024年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1. 基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2023年末,立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

立信2023年业务收入(经审计)50.01亿元, 其中审计业务收入35.16亿元, 证券业务收入17.65亿元。2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务,审计收费8.32亿元,同行业上市公司审计客户83家。

2. 投资者保护能力

截至2023年末,立信已提取职业风险基金1.66亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余1,000多万,在诉讼过程中	连带责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	80万元	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间际证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任,立信投保的职业保险12.5亿元足以覆盖赔偿金额。

3. 诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分无,涉及从业人员75名。

(二)项目信息

1. 基本信息

项目合伙人、拟签字注册会计师、均具有相应资质和专业胜任能力,具体如下:

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司和挂牌公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	谭红梅	2003年	2004年	2004年	2024年
签字注册会计师	钱民谢	2022年	2018年	2022年	2021年
质量控制复核人	徐志敬	2009年	2005年	2005年	2024年

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:谭红梅

时间	上市公司名称	职务
2021-2023年度	上海国际机场股份有限公司	项目合伙人
2021-2023年度	宁波三星医疗电气股份有限公司	项目合伙人
2021-2023年度	北京万东医疗科技股份有限公司	项目合伙人
2021年度	江苏卓胜微电子股份有限公司	项目合伙人
2023年度	贵州中毅达股份有限公司	项目合伙人

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:钱民谢

时间	上市公司名称	职务
2022-2023年度	陕西源杰半导体科技股份有限公司	签字注册会计师

(下转B062版)

证券代码:688498 证券简称:源杰科技

陕西源杰半导体科技股份有限公司

【2024】第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	60,063,175.77	72.33
归属于上市公司股东的净利润	10,534,967.18	-11.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,570,094.24	109.72
经营活动产生的现金流量净额	22,407,486.05	不适用
基本每股收益(元/股)	0.12	-40.00
稀释每股收益(元/股)	0.12	-40.00
加权平均净资产收益率(%)	0.50	减少0.06个百分点
研发投入合计	8,950,721.46	37.07
研发投入占营业收入的比例(%)	14.90	减少3.84个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,231,464,398.79	2,236,682,340.61	-0.23
归属于上市公司股东的所有者权益	2,112,907,536.34	2,116,687,842.73	-0.18

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	33,665.91	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	273,722.56	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外、非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	827,756.16	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	170,271.69	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	964,872.94	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常